

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

ML8

Erstellt:

Wodke, Alexander

Kunde:

Datum:

06.09.2022



Prozesstechnik: B: Pinlamination C: Pinlamination

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		2
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	33	L2	3
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	124		4
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		5
A-RS-FR4-ML-0.36mm-035+035-TG150-HF	50200657	33	L3	6
		360		
		33	L4	
A-RS-FR4-ML-0.36mm-035+035-TG150-HF	50200657	110		7
		0		
A-RS-FR4-ML-0.36mm-035+035-TG150-HF	50200657	33	L5	9
		360		
		33	L6	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	124		10
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		11
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	33	L7	12
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	60		13
A-RS Kupferfolie-009my 330x490mm	50201012	9	RS	14

B00: C00

Dicke nach Verpressen

B00: 1240 µm

Tol+: 128 µm

Tol-: 128 µm

Dmax: 1368 µm

Dmin: 1112 µm

C00: 1440 µm

Tol+: 155 µm

Tol-: 155 µm

Dmax: 1595 µm

Dmin: 1285 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+: 0 µm

Tol-: 0 µm

Dmax: 0 µm

Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 1550 µm

Tol+: 155 µm

Tol-: 155 µm

Dmax: 1705 µm

Dmin: 1395 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal: 1414 µm

Version 1.2.20.19

© Würth Elektronik